

Telit、IDY 初の 5G/ギガビット LTE 企業向けゲートウェイに 5G データカードを供給

- Telit の FN980m 5G データカードは、オフィスや屋外での超高速無線接続を可能とし、監視カメラや 4K/8K ビデオなど、帯域幅を必要とする用途に最適
- IDY の 5G エッジゲートウェイは、3GPP Rel. 15 で高度化された 5G 無線ネットワークを容易に利用することが可能

ロンドン発、2020 年 5 月 21 日 - IoT(モノのインターネット)を促進する世界的なリーダーTelit は、日本の M2M イネーブラーである IDY の 5G loM[®] エッジゲートウェイ iR730B に FN980m 5G データカードモジュールが採用されたと発表しました。Telit の FN980m は Qualcomm[®] Snapdragon[™] X55 5G Modem-RF システムを搭載しており、支店や支社でのコネクティビティ、業務レベルのビデオブロードキャスティング、デジタルサイネージ、その他の高性能のビジネス用途向けに最適です。詳細は、<https://www.telit.com/5g-ready-modules-data-cards/>をご覧ください。

IDY は、成長する IoT / M2M 市場で信頼性の高いワイヤレステクノロジーを中心に顧客の要求に応えてきました。LTE 搭載ルーター/ゲートウェイ製品は、自動販売機、デジタルサイネージ、高速鉄道、AI ロボット、キオスク端末など、目にする多くの機械で使用されています。サステナブルで信頼性の高いネットワークが求められる中、5G を用いた新しいサービスや利便性の向上が期待されています。IDY は、5G ネットワークのメリットを享受できるこれらの既存および新規の用途に対応することを目的として、iR730B を開発し Telit FN980m 5G データカードを採用しました。

FN980m は Sub-6 GHz 帯の主要周波数に対応しており、市場への展開時に高い柔軟性を得ることができます。また、本データカードは、Qualcomm[®] QTM525 mmWave アンテナモジュールに対応し、低消費電力を維持しながら低地の屋内および屋外でも最大限のパフォーマンスを発揮します。さらに、高所屋外用途向け Qualcomm[®] QTM527 mmWave extended-range (範囲拡張) アンテナモジュールにも対応しています。

株式会社 IDY 代表取締役社長である本田和明氏は次のように述べています。「iR730B は高度化アプリケーションの搭載を可能にした高信頼性ゲートウェイ iR720B の遺伝子を継承し、高速通信に特化し設計されました。5G データカードを格納できるよう 40 x 52 [mm] に拡張されたモジュールベイに加え、GbE 有線 LAN、RS232/485、DIO など従来機能をそのまま同サイズに詰め込みました。デュアルコア CPU により 5G と併せたエッジコンピューティングが可能です。」

Telit の 5G 技術担当副社長である Marco Contento は次のように述べています。「IDY の新しい iR730B エッジゲートウェイは、Telit が世界のどの OEM 供給先に対してもよりも早く最新技術を提供し、リーダーシップ的役割を果たしていることを示しています。今回の最新技術とは、新たに標準化された 3GPP Rel. 15 規格 と Qualcomm Technologies の第 2 世代 Snapdragon X55 5G Modem-RF システムです。Telit の FN980m は、将来性のある IoT、企業向けの用途、および日



本のビジネスインフラの基盤となり、FN980mを採用することで5GやギガビットLTEのあらゆるメリットをより早く簡単に享受できます。」

FN980mの主な特徴

- M.2 (NGFF) 30x50mm、フォームファクタ
- 5G Sub-6 および mmWave、SA および NSA オペレーション
- 4G Cat 20、最大 7CA、256 QAM DL/UL、2CA UL
- 4×4 MIMO (4G および 5G (Sub-6 帯))
- 3G HSPA+
- GNSS gpsOne Gen9 L1/L5 帯

Telit について

Telit (AIM 市場コード: TCM) は、「モノのインターネット (IoT)」の実現を促進する世界的なリーダー企業であり、ワイヤレスコネクティビティモジュール、プラットフォーム、バーチャルセルラーによる IoT オペレーターサービス、および専門的なサービスといった豊富なポートフォリオにより、これまでに何億もの「モノ」の繋がりを実現し、世界中で直接および間接的なお客様からの信頼を獲得してきました。20 年近く IoT イノベーションを手がけてきた Telit は、セキュアでエンド・ツー・エンドの統合型 IoT ソリューションを、企業、OEM、システムインテグレーター、サービスプロバイダーなど、あらゆる業界の世界的な大手ブランドに提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションへの貢献を通じてデジタルビジネスを推進しています。

###

Qualcomm and Snapdragon are trademarks of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm QTM525, and Qualcomm QTM527 are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Copyright © 2020 Telit Communications PLC. All rights reserved. Telit, Telit OneEdge and all associated logos are trademarks of Telit Communications PLC in the United States and other countries. Other names used herein may be trademarks of their respective owners.

◆本件に関するお問い合わせ先◆

Telit Wireless Solutions Japan 株式会社 担当: 佐藤

Mail: Osamu.Sato@telit.com

Web サイトからのコンタクト: <https://www.telit.com/about/company-information/our-locations/#locations-sales-offices-apac>